



報道関係各位

DIC株式会社

〒103-8233 東京都中央区日本橋 3-7-20  
ディーアイシービル  
Tel: 03-3272-4511  
Fax: 03-3278-8558

2010年1月27日

各位

DIC株式会社

溶剤可溶性イミド樹脂「ユニディック V-8000 シリーズ」の新製品「V-8004」を開発  
-銅と同じレベルの線膨張係数で電子回路の損傷や歪みを防止。一液タイプとしての運用も可能-

DIC株式会社（本社：東京都中央区、社長：杉江和男）は、溶剤可溶性イミド樹脂の新製品「ユニディック V-8004」（以下 V-8004）を開発し、顧客に対するサンプルの配布を開始しました。

イミド樹脂は、優れた耐熱性と絶縁性を特徴としていますが、各種溶剤や他の樹脂との相溶性が低く、また硬化させるには 300℃以上の高温を必要とするため、配合やアプリケーションに大きな制約がありました。当社では、独自の技術により、このようなイミド樹脂の難点を克服した可溶性イミド樹脂「ユニディック V-8000 シリーズ」の開発にすでに成功しています。

同シリーズは、電子部品（半導体やプリント配線基板）の絶縁体や、高耐熱性・高絶縁性コーティング剤、接着剤向けなどに鋭意サンプルワーク中で、各種溶剤や他の樹脂との相溶性を大幅に向上したタイプや低温硬化タイプなどを取り揃えています。（弊社のプレスリリース 2009年7月1日付けにて既報の通りです。）

このたび開発した同シリーズの新製品 V-8004 では、各種溶剤との相溶性など、同シリーズの優れた特性に加え、硬化塗膜に銅とほぼ同じレベルの低い線膨張係数（注）を持たせることに成功しました。これにより、プリント配線基板等の電子回路に導電体として使用される銅が外部の温度変化により変形した場合でも、V-8004 の硬化塗膜が同様に変形するので、電子回路の損傷や歪みが防止できます。V-8004 のこのような特性は、電子回路の精密化への対応として注目されます。

また、硬化剤を配合した際の安定性も確認されていることから、顧客の要望に応じて当社で硬化剤を配合し、一液タイプとして出荷することもできるため、顧客の作業手間やコストを省くことも可能です。

代表物性値（保証値ではありません）

V-8004 は同シリーズの既存品である V-8000 が持つ優れた特性も併せ持っています。

製品	硬化剤の要否	Tg (°C)	熱分解温度 (°C)	吸水率 (%)	線膨張係数
V-8000	要 (2液)	265	370	< 0.01	55 ppm
V-8004	要 (1液可)	294	400	0.3	17 ppm

なお、V-8004 は化審法における少量新規物質ですが、需要動向の調査を経て早期に化審法登録し、商業生産へと進める予定です。

(注) 線膨張係数・・・温度の上昇に対応して物質の長さが変化する割合

本件に関する報道機関からのお問い合わせ・・・広報・IR部

TEL 03-5203-7838

本件に関するお客様からのお問い合わせ・・・コーティング樹脂開発営業部

TEL 03-5203-7718